

## РАЗРАБОТКА

- разработка 3d модели
- промышленный дизайн
- разработка конструкторской документации
- тепловой расчет
- прочностной расчет
- разработка системного ПО
- разработка прикладного и тестового ПО
- разработка WEB
- разработка эксплуатационной документации
- разработка технологической документации

## ПРОИЗВОДСТВО

- изготовление опытных и установочных партий

## ИСПЫТАНИЯ

- разработка программ-методик испытаний, ТУ
- проведение функциональных испытаний
- проведение испытаний на внешние воздействующие факторы
- сертификация ТС
- метрологическая сертификация
- отраслевая аттестация
- получение заключений

## СОПРОВОЖДЕНИЕ

- сопровождение потребителя,
- оперативная поддержка
- проведение обучения
- анализ предложений по совершенствованию и развитию продуктовой линейки

Магистрально-модульные системы – это информационно-вычислительные комплексы, предназначенные для установки, электропитания, охлаждения и подключения к сигнальным цепям вычислительных и коммуникационных (периферийных) модулей единого стандарта.

Система ГОРТ – это гибкое, конфигурируемое решение на основе механического стандарта евро-плат, объединяемых при помощи интерфейсов и топологий сети, описанных в открытых стандартах консорциумов PICMG и VITA. Точное соответствие механическим стандартам обеспечивают системам ГОРТ совместимость с модулями пользовательской разработки стандартов CPCI, VME/ VME64x, VPX, VXS и их версий.



## ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ГОРТ

- Модульная архитектура – возможность совмещать модули с разными функциями позволяет быстро адаптировать комплекс к текущим задачам;
- Надежность механической фиксации – разъемы в сочетании с клиновыми зажимами, кондуктивными направляющими и ручками-экстракторами позволяют повышать вибро- и ударостойкость системы до 25g;
- Следование стандартам евромеханики IEEE 1101.1, 1101.10/11 и IEC 60297-3 обеспечивает совместимость модулей различных производителей, а также плат индивидуальной разработки;
- Отказоустойчивость обеспечивается благодаря системе активного воздушного охлаждения с пропускной способностью до 810 куб.м/час и электропитанию с опциями горячей замены, резервирования, а также системе контроля температуры/ среды, и других технологий, нацеленных на снижение вероятности отказа.



ГОРТ

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ Compact PCI/ Compact PCI PlusIO

Применимые стандарты	PICMG 2.0 R3.0, 2.1 R2.0, 2.9 R1.0, 2.10 R1.0, 2.16 R1.0, 2.20 R1.0, 2.30 IEEE 1101.1, 1101.10/11 IEC 60297-3-101, -102, -103
Количество слотов	6 ... 14
Разрядность шины	32/ 64 bit
Размер плат/ модулей	3U/ 6U
Источник питания	100...240 В/ 250 ... 450 Вт, тип Open Frame/ Roal
Вентиляторы охлаждения	Осевые (радиальные под заказ), управляемые, под заказ с функцией горячей замены
Индикация	С фронта шасси: 5, 12, -12 В, внешняя температура, перегрев
Rear I/O	Под заказ
Экранирование	~40 дБ/ 1ГГц *
Управление средой	Модуль управления вентиляторами, под заказ модуль удаленного управления шасси shelf controller
Дополнительные слоты под заказ	DVDRW, Compact Flash, HDD SATA, SSD mSATA, платы с пользовательским интерфейсом
Т эксплуатации, °С	0 ... +40 (под заказ -20... +55)
Т хранения/ транспортировки, °С	-40...+85
Влажность	От 30 до 95%, без конденсата

\* - при использовании в платах/ модулях экранированных передних панелей



### СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ VME/VME64x, VPX, VXS

Применимые стандарты	ANSI/ VITA 1-1994, 1.1-1997, 1.5-2003, 1.7-2003, 3-1195, 38-2003, 41-2006 IEEE 1101.1, 1101.10/11 IEC 60297-3-101, -102, -103
Количество слотов	6 ... 14
Размер плат/ модулей	3U/ 6U
Источник питания	100...240 В/ 440 ... 740 Вт, тип Open Frame/ Roal
Вентиляторы охлаждения	Осевые (радиальные под заказ), управляемые, под заказ функция горячей замены
Индикация	С фронта шасси: 5, 12, -12 В, внешняя температура, перегрев
Экранирование	~40 дБ/ 1ГГц *
Управление средой	Встроенный модуль fan-control, под заказ модуль удаленного управления шасси shelf controller
Дополнительные порты под заказ	DVDRW, Compact Flash, HDD SATA, SSD mSATA, платы с пользовательским интерфейсом
Т эксплуатации, °С	0 ... +40
Т хранения/ транспортировки, °С	-40...+85
Влажность	От 30 до 95%, без конденсата

\* - при использовании в платах/ модулях экранированных передних панелей

